



Fully Automatic In-Feed Surface Grinder DFG8540/8560

顺应晶圆技术发展潮流，实现超薄、大口径晶圆加工

汇集现有研削机的精华

DFG8540/8560 是在世界各地拥有很多用户的 DFG800 系列的升级换代机种。该机种既具备了与 800 系列同样的技术指标及性能，又在设备的重量方面取得了重大改进。DFG8540 的重量比原来减少了 1.2 t (比 DFG850 降低 28%)，DFG8560 的重量比原来减少 1.0 t (比 DFG860 降低 20%)。

可对 100 μm 以下的超薄晶圆进行精密研削

改善超薄晶圆研削及搬运系统的功能参数设计，提高了超薄研削精加工的稳定性。

具有对应超薄研削精加工技术的系统扩张功能

可以与 DBG (Dicing Before Grinding=先分割晶圆，后进行研削) 和干式抛光机 (DFP8140/8160) 等组成联机系统。



DFG8560

统一研削加工点，提高加工可信度

通过将第一主轴的研削加工点与第二主轴的研削加工点位置统一，不但提高了第二主轴的研削加工稳定性，而且减小了单片晶圆内的厚度误差和晶圆之间的厚度误差，还有助于提高超薄研削加工质量的稳定性。

维持与现有 DFG800 系列间的兼容性及零部件互换性

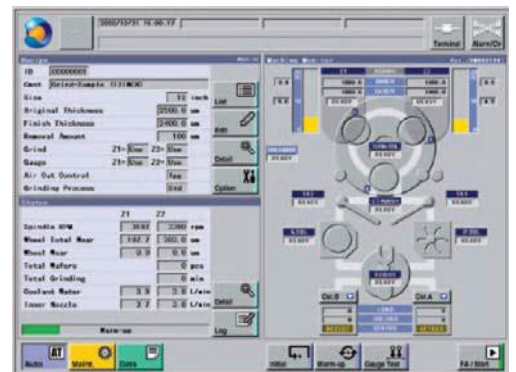
DFG8540/8560 维持与现有机种的互换性，可以使用与 DFG800 系列机相同的研削磨轮，磨轮修整板，工作台。

操作简便

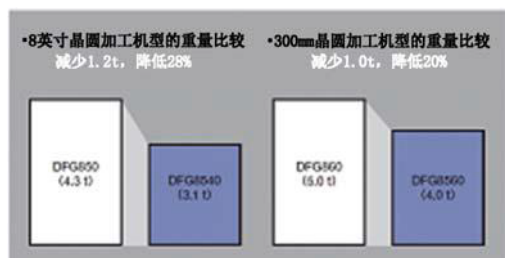
DFG8540/8560 配置了触摸式液晶显示器及图形化用户接口 GUI (Graphical User Interface)，提高了操作便利性。而且设备的机械状态和加工状况可在控制画面上同步显示。操作人员通过触摸控制画面上的图形化按钮，就可以简单地完成操作，不但加快了作业速度，还使设备操作和维修保养都变得非常容易。



便携式控制屏



操作画面



Fully Automatic In-Feed Surface Grinder DFG8540/8560



薄型工作物的机械手臂搬运变得更加安全可靠



DFG8540

Specifications

Specification		Unit	DFG8540	DFG8560	
Wafer diameter		-	φ 8" (φ 4"/5"/6"/8")	φ 300 (φ 200/φ 300)	
Grinding method		-	In-feed grinding with wafer Rotation		
Grinding wheels		mm	φ 200(φ 8") Diamond wheel	φ 300 Diamond wheel	
Spindle	Rated output	kW	4.2	4.8	
	Rated torque range	min ⁻¹	1,000 ~ 7,000	1,000 ~ 4,000	
Grinding Accuracy	BG	Thickness variation within one wafer	μm	1.5 or less (with dedicated chuck table)	3.0 or less (with dedicated chuck table, φ 300mm wafer)
		Thickness variation between wafers	μm	±3.0 or less	
	Finished surface roughness	μm	Ry 0.13(with #2000 finish) Ry 0.15(with #1400 finish)		
Machine dimensions(WxDxH)		mm	1,200 x 2,670 x 1,800	1,400 x 3,190 x 1,800	
Machine weight		kg	Approx.3,100	Approx.4,000	

■使用条件

- 请使用大气压露点在-15℃以下，残余油分为0.1ppm，过滤度在0.01μm/99.5%以上的清洁压缩空气。
- 请将放置机械设备的房间室温设定在20℃-25℃之间，并将波动范围控制在±1℃以内。
- 请将切削水的水温控制为室温+2℃（波动范围在±1℃以内），将冷却水的水温控制为与室温相同（波动范围在±1℃以内）。
- 其它，请避免设备受到撞击及外界的可感振动。另外，请不要将设备安装在鼓风机、通风口、产生高温的装置及产生油雾的装置附近。
- 本设备会使用水。万一发生漏水影响，请把本设备安装在有防水性之地板及有排水处理的场所。
- ※为了改进设备，本公司可能在预先不通知用户的情况下，就对本规格实施变更，因此请仔细确认规格后发出订单。
- ※压力全部使用压力表指示压力值表示。
- ※关于本设备的应用技术等咨询，请与本公司销售部门联络。